

4. BondExpo

Vom **13. – 16. September 2010** öffnet die Landesmesse **Stuttgart** ihre Tore zur vierten Auflage der **Bondexpo**, der Fachmesse für industrielle Kleb- und Dichttechnologie. Die Bondexpo hat zum Ziel, die gesamte Prozesskette beim Kleben, Schäumen, Vergießen, Dichten und Dämmen abzubilden. Sie findet wieder parallel zur **Motek**, der Fachmesse für Montage und Handhabungstechnik, statt, die das Equipment für die Applikation der Kleb- und Dichtstoffe oder Vergussmassen präsentiert. Bei aktuell 620 Ausstellern und 24 000 m² Nettofläche (Motek) sowie 55 Ausstellern und 1 400 m² Nettofläche (Bondexpo) erwartet Organisator **P. E. Schall** zur Veranstaltung im Herbst insgesamt über 1 000 Aussteller.

Datum und Ansprechpartner

13.09 - 16.09.2010

<http://>

Veranstaltungsort

Landesmesse Stuttgart

Messepiazza 1
70629 Stuttgart

+49 711 18560-0

<http://www.messe-stuttgart.de>
info@messe-stuttgart.de

Veranstalter

P.E. Schall GmbH & Co.KG

Gustav-Werner-Strasse 6
72636 Frickenhausen-Linsenhofen

+49 7025 9206-0

<http://www.schall-messen.de>
info@schall-messen.de

Adresse:

<http://www.gupta-verlag.com/kautschuk/veranstaltungen/messe/370/4-bondexpo>